



#2

RECEIVED
SEP 13 2001
TC-2000 MAIL ROOM

대한민국 특허청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출원번호 : 특허출원 2000년 제 22737 호
Application Number

출원년월일 : 2000년 04월 28일
Date of Application

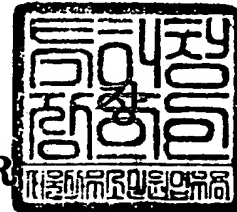
출원인 : 주식회사 엘지씨아이
Applicant(s)



2001 년 04 월 19 일

특 허 청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 출원인정보변경 (경정)신고서
【수신처】 특허청장
【제출일자】 20010416

【출원인】

【명칭】 주식회사 엘지씨아이

【출원인코드】 119980012750

【대리인】

【성명】 최규팔

【대리인코드】 919980005638

【변경사항】

【경정항목】 한글 성명(명칭)

【경정전】 주식회사 엘지화학

【경정후】 주식회사 엘지씨아이

【변경사항】

【경정항목】 영문 성명(명칭)

【경정전】 LG CHEMICAL CO.,LTD

【경정후】 LG Chem Investment, Ltd

【취지】

특허법시행규칙 제9조·실용신안법시행규칙 제12조·의장법
시행규칙 제28조 및 상표법시행규칙 제23조의 규정에 의하
여 위와 같이 신고합니다.

| | | | |
|------------|--|---|----------|
| 【서류명】 | 특허출원서 | | |
| 【권리구분】 | 특허 | | |
| 【수신처】 | 특허청장 | | |
| 【참조번호】 | 0001 | | |
| 【제출일자】 | 2000.04.28 | | |
| 【발명의 명칭】 | 저유전 절연재료의 제조방법 | | |
| 【발명의 영문명칭】 | METHOD FOR PREPARING DIELECTRICS MATERIAL WITH LOW DIELECTRIC CONSTANT | | |
| 【출원인】 | | | |
| 【명칭】 | 주식회사 엘지화학 | | |
| 【출원인코드】 | 1-1998-001275-0 | | |
| 【대리인】 | | | |
| 【성명】 | 김원호 | | |
| 【대리인코드】 | 9-1998-000023-8 | | |
| 【포괄위임등록번호】 | 1999-002560-4 | | |
| 【대리인】 | | | |
| 【성명】 | 송만호 | | |
| 【대리인코드】 | 9-1998-000261-1 | | |
| 【포괄위임등록번호】 | 1999-002562-9 | | |
| 【발명자】 | | | |
| 【성명의 국문표기】 | 고민진 | | |
| 【성명의 영문표기】 | KO,MIN JIN | | |
| 【주민등록번호】 | 640213-1042416 | | |
| 【우편번호】 | 305-340 | | |
| 【주소】 | 대전광역시 유성구 도룡동 엘지사원아파트 5동 304호 | | |
| 【국적】 | KR | | |
| 【취지】 | 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대 리인 김원 호 (인) 대리인 송만호 (인) | | |
| 【수수료】 | | | |
| 【기본출원료】 | 15 | 면 | 29,000 원 |
| 【가산출원료】 | 0 | 면 | 0 원 |

| | | | | |
|----------|-------------------|---|---|---|
| 【우선권주장료】 | 0 | 건 | 0 | 원 |
| 【심사청구료】 | 0 | 항 | 0 | 원 |
| 【합계】 | 29,000 | | | 원 |
| 【첨부서류】 | 1. 요약서·명세서(도면)_1통 | | | |

【요약서】**【요약】**

본 발명은 고밀도, 고성능의 차세대 반도체 소자에 필수적인 저유전 물질에 관한 것으로, 특히 수 나노미터 크기 이하의 기공을 함유한 다공성 저유전 층간 절연막의 제조방법에 관한 것이다.

본 발명은 이를 위하여, 반도체 소자의 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조 방법에 있어서, a) 캡핑 유기분자와 매트릭스 수지의 혼성 복합체를 제조하는 단계; b) 상기 혼성 복합체를 피착체에 코팅하고 경화하는 단계; 및 c) 상기 혼성 복합체를 가열하여 유기 분자를 제거하여 복합체 내에 기공을 형성하는 단계를 포함하는 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법을 제공한다.

본 발명의 방법으로 제조되는 다공성 초저유전 배선 층간 절연막은 상분리 현상이 억제되어 공정성과 기계적 물성이 우수하고, 이소트로픽 구조를 가지며, 분자 크기의 매우 작은 기공을 갖는 초저유전성 절연막이다.

【색인어】

다공성 저유전 층간 절연막, 캡핑 유기분자, 매트릭스 수지, 혼성 복합체, 기공, 상분리, 유기 폴리 실리케이트, 열분해

【명세서】

【발명의 명칭】

저유전 절연재료의 제조방법 {METHOD FOR PREPARING DIELECTRICS MATERIAL WITH LOW DIELECTRIC CONSTANT}

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<1> 본 발명은 고밀도, 고성능의 차세대 반도체 소자에 필수적인 저유전 물질에 관한 것으로, 특히 수 나노미터 크기 이하의 기공을 함유한 다공성 저유전 층간 절연막의 제조방법에 관한 것이다.

<2> 최근 반도체 소자의 집적도가 증가하면서 소자 내부를 연결하는 도선의 선폭이 급속하게 줄어들고 있으며, 2003년경에는 0.1 μm 의 회로 선폭을 이용한 고밀도의 소자가 개발될 것으로 예상된다. 일반적으로 반도체 소자의 속도는 트랜지스터의 스위칭 속도와 시그널(signal)의 전달 속도에 비례하고, 시그널의 전달 속도는 배선물질의 저항과 층간 절연막의 정전용량의 곱으로 표시되는 RC 지연(delay)에 의하여 결정된다. 반도체 소자의 집적도가 높아지면 소자내부를 연결하는 금속선의 길이가 기하급수적으로 증가하여, 고밀도 칩상의 속도는 스위칭 속도보다는 고 밀도 칩상의, RC 지연에 의하여 결정된다. 따라서 고속의 칩을 제조하기 위해서는 저항이 작은 도체와 유전율이 낮은 절연물질을 사용하여야 한다. 또한 저유전 물질의 사용은 반도체 소자의 속도 증가뿐만 아니라, 소비전력을 낮출 수 있고, 금속 배선간의 상호 간섭(cross-talk) 현상을 현저히 감

소시킬 수 있다.

<3> 최근 IBM에서 종래의 알루미늄 배선을 사용하지 않고, 전기 전도도가 높은 구리 배선을 사용하여 30 % 이상의 성능 향상을 보인 시제품을 출시한 바 있다. 반면에 저유전 물질을 적용한 반도체 소자는 적절한 소재 개발의 미비로 아직 시제품이 출시되어 있지 않은 상태이다.

<4> 현재 반도체 소자 제작에 사용되는 절연재료는 유전상수가 4.0 인 SiO_2 가 대부분이며, 저유전 물질로 F- SiO_2 가 일부 소자에 적용되고 있다. F- SiO_2 의 경우 F의 함량이 6 중량% 이상일 경우 열적으로 불안정한 상태가 되어 3.5 이하의 유전상수를 얻을 수 없는 단점이 있다. 유전 상수가 3.0 에서 2.5인 절연재료는 극성이 낮고 고온에서 열적으로 안정한 유기 고분자와 유기 실리케이트 고분자들이 있으며, 이를 이용한 소자 제작이 진행중이다. 차세대 고성능 고밀도의 소자 개발을 위하여 유전 상수 2.5 이하의 낮은 유전율을 갖는 중간 절연 재료의 개발이 필수적이며, 이를 위해 유전상수가 3.0 에서 2.5 인 물질에 유전 상수가 1 인 공기를 도입하려는 것이 요구된다.

<5> 공기를 도입하여 절연성을 낮추는 종래의 기술은 IBM이 유기실리케이트와 하이퍼브랜치드 고분자 또는 덴드리머를 사용하는 것이다. 이 경우 먼저 경화 과정을 통하여 유기 무기 하이브리드를 제조하고 고온에서 유기 고분자를 제거함으로써 유전 상수 2.2 이하의 다공성 초유전체를 제조하는데 성공하였다. 하지만 기공 형성을 위하여 사용된 고분자가 매트릭스 수지와와의 상용성이 떨어져 상분리 입자가 커지기 쉽고, 고분자 함량이 많아지면 쉽게 불투명 막이 형성된다. 또한 고분자를 사용함으로써 매우 작은 기공을 형성하기 어렵고, 분자량 분포로 인하여 균일한 크기의 기공을 형성하기 어렵다.

<6> 다우 코닝에서는 기공형성을 위하여 유기고분자 대신 고 비점의 용매를 사용하였다. 이 경우 경화 반응을 거치는 동안에 고 비점의 용매가 나노 크기로 상분리 되고 이차 경화 반응을 거치는 동안에 고 비점의 용매가 증발하여 기공을 형성하는 방법이다. 하지만 이 방법은 겔화 과정 중 고 비점 용매를 상분리하기 위한 공정의 제어가 어렵고, 수 나노미터의 매우 작은 기공을 형성하기 어렵다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<7> 본 발명은 상기 종래기술의 문제점을 고려하여, 반도체 소자의 고속화와 소비 전력량 감소가 가능하며, 금속 배선의 상호 간섭 현상을 현저히 줄일 수 있는 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

<8> 본 발명의 다른 목적은 수 나노미터 크기 이하의 균일한 기공을 함유한 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법을 제공하는 것이다.

<9> 본 발명의 다른 목적은 상분리 현상이 적은 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법을 제공하는 것이다.

【발명의 구성 및 작용】

<10> 본 발명은 상기 목적을 달성하기 위하여, 반도체 소자의 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법에 있어서,

<11> a) 캡핑 유기분자와 매트릭스 수지의 혼성 복합체를 제조하는 단계;

<12> b) 상기 혼성 복합체를 피착체에 코팅하고 경화하는 단계; 및

<13> c) 상기 혼성 복합체를 가열하여 유기 분자를 제거하여 복합체 내에 기공을

<14> 형성하는 단계

- <15> 를 포함하는 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법을 제공한다.
- <16> 또한 본 발명은 상기 제조방법에 의해 제조되는 반도체 소자의 금속 배선 층간 절연막을 제공한다.
- <17> 또한 본 발명은 상기 제조방법에 의해 제조되는 반도체 소자의 금속 배선 층간 절연막을 포함하는 반도체 소자를 제공한다.
- <18> 이하에서 본 발명을 상세하게 설명한다.
- <19> 본 발명에서 제조하고자 하는 저유전 물질은 고분자 물질이 아닌 캡핑 유기 분자를 매트릭스 수지와 반응시켜 혼성 복합체를 만들고, 캡핑 유기 분자를 열 분해로 제거함으로써 기공을 형성시키는 방법이다. 이 방법은 종래의 방법보다 상분리 현상이 억제되어 공정성과 기계적 물성이 우수하고, 이소트로픽 구조를 가지며, 분자 크기의 매우 작은 기공을 갖는 절연막을 형성할 수 있다.
- <20> 금속 배선 층간 저유전 절연막은 매트릭스 수지인 유기 실리케이트와 기공 형성 유기 분자를 사용하여 스핀 코팅 방법으로 제조하고 경화 공정과 유기 분자 분해 공정 두 단계를 거쳐 제조한다. 그 일반적인 방법으로는 상온에서 층을 만들고자 하는 물질 위에 원하는 두께로 코팅한다. 이때 코팅의 두께는 유기 실리케이트와 기공 형성 유기 분자의 양과 스핀 속도로 조절할 수 있다. 코팅 후에는 분당 3 °C로 상온에서 250~350 °C 까지 승온시킨 다음 2 시간 동안 유지시켜 기공 형성 유기분자를 함유한 복합체 절연막을 제조한다. 다시 분당 3 °C로 400~450 °C까지 승온시킨 다음, 그 온도에서 2 시간 유지시킨다. 이때 유기분자가 열분해 되어 밖으로 나오고 유기 분자가 차지하는 부분이 기공으로 형성된다. 기공의 크기는 열분해 되는 유기분자의 크기와 사용한 매트릭스

수지인 유기 실리케이트로 조절이 가능하며 일반적으로 수 나노미터 이하 크기의 매우 작은 기공을 형성할 수 있고, 상분리 현상이 적어 공정성이 매우 우수하다.

<21> 본 발명에서 사용 가능한 매트릭스 수지는 실리콘, 탄소, 산소, 수소로 구성된 실란 모노머 또는 이로부터 제조되는 유기 폴리 실리케이트 고분자이다. 바람직하게는 하기 화학식 1로 표시되는 화합물, 또는 이로부터 제조되는 폴리 실록산 유기 실리케이트 고분자; 또는

<22> 하기 화학식 1로 표시되는 화합물, 하기 화학식 2로 표시되는 화합물, 하기 화학식 3으로 표시되는 화합물, 하기 화학식 4로 표시되는 화합물, 및 하기 화학식 5로 표시되는 화합물로 이루어진 군으로부터 단독 또는 두 성분 이상을 일정한 비율로 혼합하여 제조한 실란 화합물, 또는 이로부터 제조되는 공중합체의 유기 실리케이트 고분자이다.

<23> [화학식 1]

<24> RSiX_3

<25> [화학식 2]

<26> R_2SiX_2

<27> [화학식 3]

<28> SiX_4

<29> [화학식 4]

<30> $\text{X}_3\text{Si-M-SiX}_3$

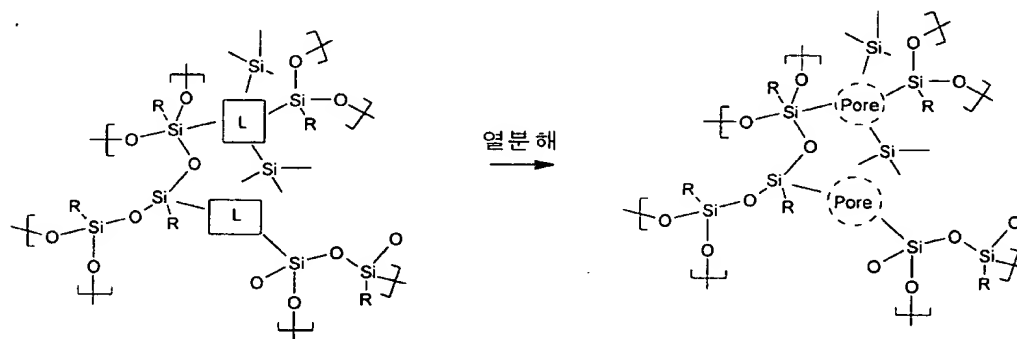
<31> [화학식 5]

<32> $\text{X}_2\text{RSi-M-SiRX}_2$

- <33> 상기 화학식 1, 2, 3, 4 및 5의 식에서,
- <34> R은 수소, 알킬, 또는 페닐이고, X는 염소, 알콕시, 또는 아세톡시이며,
- <35> M은 에틸렌과 같은 알킬렌, 또는 페닐과 같은 알릴이다.
- <36> 본 발명에서 사용된 기공 형성 물질인 캡핑 유기분자는 200~450 °C에서 분해가 가능한 유기분자로, 분자 말단에 실란 캡핑이 가능한 관능기(하이드록시 또는 비닐)를 최소한 1 개 이상 갖는 것이다. 캡핑된 분자는 유기 폴리 실리케이트와 혼합하여 사용하거나, 유기 폴리 실리케이트 제조시 첨가하여 공중합체로 만들어 사용할 수 있다.
- <37> 아래에서 본 발명에 의하여 제조된 기공 형성 유기분자를 함유한 복합 절연재와 기공형성을 하기 구조식 1에 나타내었다.

<38> [구조식 1]

<39>



- <40> 상기 식에서, L은 기공 형성을 유기 분자이다.
- <41> 이하의 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다. 단, 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이지 이들만으로 한정하는 것이 아니다.
- <42> [실시예]
- <43> 실시예 1

- <44> (기공 형성 캡핑 유기분자를 함유한 유기 실리케이트 제조)
- <45> 펜타에리트리톨테트라 아크릴레이트(테트라머) 1.5 g에 백금 촉매(Kartedt cat.) 20 μ l를 첨가하여 약 15 분 동안 반응시킨 후, 트리메톡시실란 5.8 ml를 첨가하여 10 시간 반응시킨다. 반응은 NMR 스펙트럼으로 확인하고 남아있는 실란은 45 $^{\circ}$ C, 진공 하에서 제거한다.
- <46> 생성물에 테트라하이드로퓨란 20 ml 과 메틸트리메톡시 실란 5.9 ml를 첨가하여 용액이 투명할 때까지 교반시킨 후, 여기에 물 0.2 ml과 2 N 하이드로클로린산 1.45 ml를 주사기를 이용하여 천천히 첨가하였다. 이때 사용된 테트라머의 양은 전체 중량의 10 중량% 정도를 차지하고, 실온에서 6 시간 정도 반응시켰다.
- <47> 반응 후 톨루엔으로 희석시킨 후, 물로 pH가 중성이 될 때까지 씻어준다. 얻어진 유기층은 유기용매를 진공 오븐에서 완전히 제거한다.
- <48> (절연막 제조)
- <49> 얻어진 파우더 300 mg을 메틸이소부틸케톤에 녹여 전체 용액이 1.5 g이 되게 한다. 얻어진 용액은 필터를 통하여 불순물을 제거한 후 스핀 코팅하여 박막을 얻고, 질소 분위기하에서 250 $^{\circ}$ C와 430 $^{\circ}$ C에서 각각 1 시간씩 경화 공정과 유기분자 제거 공정을 거쳐 다공성 절연막을 제조한다.
- <50> 실시예 2
- <51> (유기 실리케이트 제조)
- <52> 20 ml의 테트라하이드로 퓨란 용매에 메틸트리메톡시 실란 8.6 ml와 물 0.66 ml를 섞은 후 질소 하에서 2 N 하이드로클로린산 1.5 ml를 천천히 첨가해 준다. 30 분간 실

온에서 반응시키고 다시 온도를 80 ℃로 올린 후 가열 환류시키면서 5 시간 동안 반응시킨다. 반응 후 용액은 뿌옇게 변하고 이 용액을 다시 실온으로 내린 후 톨루엔 용매로 희석하고 물로 중성이 될 때까지 씻어 준다. 얻어진 유기 층은 진공 오븐에서 유기용매를 완전히 제거한다.

<53> (절연막 제조)

<54> 이때 얻어진 유기 실리케이트는 실시예 1의 방법으로 얻어진 기공 형성 캡핑 유기 분자와 혼합하여 같은 방법으로 다공성 절연막을 제조한다.

<55> 실시예 3

<56> (유기 실리케이트 제조)

<57> 7.7 ml의 테트라하이드로 퓨란 용매에 메틸트리메톡시 실란 8.6 ml, 디메틸디메톡시 실란 2.0 ml와 물 0.33 ml를 섞은 후 질소 하에서 2 N 하이드로클로린산 0.75 ml를 천천히 첨가해 준다. 30 분간 실온에서 반응시키고, 다시 온도를 80 ℃로 올린 후 가열 환류시키면서 13 시간 동안 반응시킨다. 반응 후 용액은 뿌옇게 변하고 이 용액을 다시 실온으로 온도를 내린 후 톨루엔 용매에 희석하고 물로 중성이 될 때까지 씻어 준다. 얻어진 유기층은 진공 오븐에서 유기용매를 완전히 제거한다.

<58> (절연막 제조)

<59> 이때 얻어진 유기 실리케이트는 실시예 1의 방법으로 얻어진 기공 형성 캡핑 유기 분자와 혼합하여 같은 방법으로 다공성 절연막을 제조한다.

<60> 실시예 4

<61> (유기 실리케이트 합성)

<62> 15 ml의 테트라하이드로퓨란 용매에 5.73 g의 메틸트리메톡시실란과 1.14 g의 비스 트리메톡시실릴에텐을 섞은 후, 질소 하에서 온도를 0 °C로 낮추고 충분히 섞어 준다. 이 혼합용액에 50.7 mg의 2 N 하이드로클로린산을 1.82 g의 증류수에 묶힌 수용액을 천천히 첨가해 준다. 약 15 분 후 온도를 70 °C 정도로 올린 후 가열 환류시키면서 36 시간 동안 반응시킨다. 12 시간 정도 반응시키면 용액을 뿌연 상태가 되며 이후로는 뿌연 상태가의 정도가 달라지지 않는다. 36 시간 후 뿌연 용액을 상온으로 식힌 후 30 ml의 테트라하이드로퓨란 용매와 150 ml의 톨루엔 용매로 묶힌 후 이 유기층을 180 ml의 증류수로 씻어 pH를 5 이상으로 중화시킨다. 얻어진 유기층은 진공 오븐에서 유기용매를 완전히 제거한다.

<63> (절연막 제조)

<64> 이때 얻어진 유기 실리케이트는 실시예 1의 방법으로 얻어진 기공 형성 캡핑 유기 분자와 혼합하여 같은 방법으로 다공성 절연막을 제조한다.

<65> 실시예 5

<66> (기공 형성 캡핑 유기분자 제조)

<67> 실온에서 3,9-다이비닐-2.4.8.10-테트라옥사스피로 [5,5] 운데칸 1.8 g에 백금 촉매 20 μ l와 트리에톡시 실란 8.4 ml을 넣고, 질소 분위기에서 10 시간 정도 반응시킨다. 반응은 NMR 스펙트럼으로 확인하고 남아있는 실란은 45 °C, 진공 하에서 제거한다.

<68> (절연막 제조)

<69> 이때 얻어진 기공 형성 캡핑 유기 분자는 실시예 2의 방법으로 얻어진 유기실리케이트 고분자와 혼합하여 실시예 1과 같은 방법으로 다공성 절연막을 제조한다.

【발명의 효과】

<70> 본 발명의 방법으로 제조되는 다공성 초저유전 배선 층간 절연막은 상분리 현상이 억제되어 공정성과 기계적 물성이 우수하고, 이소트로픽 구조를 가지며, 분자 크기의 매우 작은 기공을 갖는 초저유전성 절연막이다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

반도체 소자의 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법에 있어서,

a) 캡핑 유기분자와 매트릭스 수지의 혼성 복합체를 제조하는 단계;

b) 상기 혼성 복합체를 피착체에 코팅하고 경화하는 단계; 및

c) 상기 혼성 복합체를 가열하여 유기 분자를 제거하여 복합체 내에 기공을

형성하는 단계

를 포함하는 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 a)단계의 혼성 복합체는 캡핑 유기 분자와 매트릭스 수지의 혼합물인 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법.

【청구항 3】

제 1 항에 있어서,

상기 a)단계의 혼성 복합체는 캡핑 유기 분자와 매트릭스 수지의 공중합체인 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법.

【청구항 4】

제 1 항에 있어서,

상기 a)단계의 캡핑 유기분자는 분해온도가 200~450 °C이고, 분자 말단에 실란 캡

평이 가능한 하이드록시, 또는 비닐의 관능기를 적어도 1 개 이상 갖는 유기 분자인 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법.

【청구항 5】

제 1 항에 있어서,

상기 a)단계의 매트릭스 수지가 실리콘, 탄소, 산소, 및 수소를 포함하는 유기 폴리 실리케이트인 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법.

【청구항 6】

제 5 항에 있어서,

상기 매트릭스 수지가

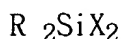
하기 화학식 1로 표시되는 화합물, 또는 이로부터 제조되는 폴리 실록산 유기 실리케이트 고분자; 또는

하기 화학식 1로 표시되는 화합물, 하기 화학식 2로 표시되는 화합물, 하기 화학식 3으로 표시되는 화합물, 하기 화학식 4로 표시되는 화합물, 및 하기 화학식 5로 표시되는 화합물로 이루어진 군으로부터 단독 또는 두 성분 이상을 일정한 비율로 혼합하여 제조한 실란 화합물, 또는 이로부터 제조되는 공중합체의 유기 실리케이트 고분자인 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법:

[화학식 1]



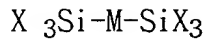
[화학식 2]



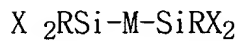
[화학식 3]



[화학식 4]



[화학식 5]



상기 화학식 1, 2, 3, 4 및 5의 식에서,

R 은 수소, 알킬, 또는 페닐이고, X는 염소, 알콕시, 또는 아세톡시이며,

M은 에틸렌과 같은 알킬렌, 또는 페닐과 같은 알릴이다.

【청구항 7】

제 1 항에 있어서,

상기 b)단계의 경화온도가 200 내지 350 ℃인 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법.

【청구항 8】

제 1 항에 있어서,

상기 c)단계의 가열온도가 400 내지 450 ℃인 다공성 초저유전 배선 층간 절연막의 제조방법.

【청구항 9】

제 1 항 기재의 제조방법으로 제조되는 다공성 초저유전 배선 층간 절연막.

【청구항 10】

제 1 항 기재의 제조방법으로 제조되는 다공성 초저유전 배선 층간 절연막을 포함하는 반도체 소자.

| | | |
|------------|-------------------|-----------------|
| 【서류명】 | 서지사항 | 보정서 |
| 【수신처】 | 특허청장 | |
| 【제출일자】 | 2000.05.03 | |
| 【제출인】 | | |
| 【명칭】 | 주식회사 | 엘지화학 |
| 【출원인코드】 | 1-1998-001275-0 | |
| 【사건과의 관계】 | 출원인 | |
| 【대리인】 | | |
| 【성명】 | 김원호 | |
| 【대리인코드】 | 9-1998-000023-8 | |
| 【포괄위임등록번호】 | 1999-002560-4 | |
| 【사건의 표시】 | | |
| 【출원번호】 | 10-2000-0022737 | |
| 【출원일자】 | 2000.04.28 | |
| 【발명의 명칭】 | 저유전 | 절연재료의 제조방법 |
| 【제출원인】 | | |
| 【접수번호】 | 1-1-00-0085274-00 | |
| 【접수일자】 | 2000.04.28 | |
| 【보정할 서류】 | 특허출원서 | |
| 【보정할 사항】 | | |
| 【보정대상 항목】 | 발명자 | |
| 【보정방법】 | 정정 | |
| 【보정내용】 | | |
| 【발명자】 | | |
| 【성명의 국문표기】 | 고민진 | |
| 【성명의 영문표기】 | KO,MIN JIN | |
| 【주민등록번호】 | 640213-1042416 | |
| 【우편번호】 | 305-340 | |
| 【주소】 | 대전광역시 유성구 도룡동 | 엘지사원아파트 5동 304호 |
| 【국적】 | KR | |

【발명자】

【성명의 국문표기】

남혜영

【성명의 영문표기】

NAM, HYE YEONG

【주민등록번호】

751007-2388219

【우편번호】

361-272

【주소】

충청북도 청주시 흥덕구 복대2동 보성아파트
103동 407호

【국적】

KR

【발명자】

【성명의 국문표기】

신동석

【성명의 영문표기】

SHIN, DONG SEOK

【주민등록번호】

700129-1140621

【우편번호】

138-240

【주소】

서울특별시 송파구 신천동 17-2 시영아파트 48
동 207호

【국적】

KR

【발명자】

【성명의 국문표기】

문명선

【성명의 영문표기】

MOON, MYUNG SUN

【주민등록번호】

711015-2149517

【우편번호】

302-122

【주소】

대전광역시 서구 둔산2동 동지아파트 104동
1306호

【국적】

KR

【발명자】

【성명의 국문표기】

강정원

【성명의 영문표기】

KANG, JUNG WON

【주민등록번호】

741102-1010813

【우편번호】

139-230

【주소】

서울특별시 노원구 하계동 극동아파트 2동 306
호

【국적】

KR

【취지】

특허법시행규칙 제13조의 규정에 의하여 위와 같이 제출합
니다. 대리인
김원호 (인)

1020000022737

출력 일자: 2001/4/20

【수수료】

【보정료】 0 원

【기타 수수료】 원

【합계】 0 원